



パッケージ用ソルダーレジストロードマップ

TAIYO INK's Solder Resist Roadmap for PKG substrate

FC-xGA 目標スペック Spec ● 高クラック耐性 High Crack Resistance
● 高 HAST 耐性 High HAST Resistance

TAIYO's spec	Year	2013	2014	2015	2016	2017
L/S (um) @BHAST		10 / 10	8 / 8	6 / 6	5 / 5	5 / 5
Min. SRO (um)		60	60	55	55	<50
Min. SR Thickness on Cu (um)		15	10	7.5	7.5	5
SR Elastic Modulus (GPa)		3.0-4.0	4.0-5.0	5.0-6.0	5.0-6.0	5.0-6.0
SR Tensile Strength (MPa)		50	75-80	90-100	90-100	100<
SR Elongation (%)		3.0-4.0	3.0-4.0	4.0-5.0	4.0-5.0	5.0<
Solder Resisit	Liquid	AUS703	AUS G2	AUS AZ1	AUS AZ2	
	Dryfilm			AUS AZ1-F	AUS AZ2-F	

FC-CSP Memory 目標スペック Spec ● 低反り Low Warpage
● 高 Tg High Tg
● 低 CTE Low CTE

TAIYO's spec	Year	2013	2014	2015	2016	2017
L/S (um) @BHAST		12/12-8 / 8	8 / 8	6 / 6	5 / 5	5 / 5
Min. SRO (um)		60	60	50	50	<40
SR Thickness on Cu (um)		10-15	5-10	5-7.5	5	<5
SR Tg (deg.C)		100	140-150	150-175	150-175	175-200
SR CTE alpha 1 (ppm)		55	25-45	15-20	15-20	<15
SR Elastic Modulus (GPa)		3.0-4.0	4.0-5.0	10.0<	10.0<	10.0<
Solder Resisit	Liquid	AUS320			AUS G3	
	Dryfilm	AUS410	AUS SR1 AUS SR2	AUS SR3	AUS SR4	

Copyright 2014 TAIYO INK MFG. CO.,LTD All Rights Reserved.